



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO "ACHILLE MAPELLI "

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; TURISMO; LICEO SCIENTIFICO;

AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA; LICEO SPORTIVO

Via Parmenide, 18 - 20900 Monza (MB) Tel. 039/833353

C.F.: 94517440155 - CODICE: MBTD41000Q - CODICE UNIVOCO: UFFV1T

www.mapelli-monza.edu.it - mbtd41000q@pec.istruzione.it - mbtd41000q@istruzione.it

	Circolare n. 207 del 16.01.2024
A	Docenti – Genitori - Studenti della classe 5BLS
OGGETTO	Seminario Politecnico di Milano

Si comunica che la classe 5BLS si recherà al Politecnico di Milano per assistere al seguente seminario:

Comunicazioni spaziali tenuto dal prof. Giuseppe Riva.

I docenti accompagnatori saranno le proff.sse Luisa Dolce e Annamaria Pollola.

Gli studenti raggiungeranno autonomamente la sala conferenze "Emilio Gatti", edificio 20 del Politecnico di Milano via G. Ponzio 34/5 per le ore 9,40, i costi del trasporto sono a carico degli studenti.

Al termine della conferenza i ragazzi rientreranno, sempre in modo autonomo alle loro abitazioni.

L'autorizzazione alla partecipazione, riportata in calce alla presente, dovrà essere consegnata alla Professoressa Dolce entro il **giorno 17/01/2024**.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Aldo Melzi

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/1993)

AM/sg

Il sottoscritto genitore dell'alunno/a _____ della classe _____ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all'Uscita Didattica al **SEMINARIO POLITECNICO DI MILANO** del giorno **18.01.2024** ed esonera fin d'ora le autorità scolastiche da ogni responsabilità in merito al realizzarsi di comportamenti non rispettosi delle disposizioni di competenza dei responsabili accompagnatori.

Dichiara inoltre che la compilazione del presente modulo è effettuata anche in nome e per conto dell'altro genitore (o eventuale altro soggetto esercitante la potestà), nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, impegnandosi ad informare l'altro genitore in merito a quanto sottoscritto nel presente modulo.

Data.....

Firma